

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2022-012

**合肥新汇成微电子股份有限公司**  
**关于向全资子公司增资**  
**并投资建设12吋晶圆金凸块封测项目的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 增资对象：全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称“江苏汇成”）
- 增资金额：使用人民币 30,000.00 万元向江苏汇成增资，本次增资完成后，江苏汇成注册资本由人民币 26,164.02 万元增至人民币 56,164.02 万元，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）仍持有江苏汇成 100% 股权。
- 投资项目名称：12 吋晶圆金凸块封测项目
- 投资金额和建设期：预计项目投资总额人民币 32,294.90 万元，建设期计划 18 个月（不含前期工作）。
- 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
- 相关风险提示：项目实施过程中可能面临宏观经济及市场需求变化等不确定因素影响，存在一定的市场管理风险、项目管理和人员风险、项目资金风险和财务管理风险等。

**一、对外投资概述**

为实现公司优化产业布局和适度扩大 12 吋晶圆金凸块封测产能规模的目标，以承接更多的订单及挖掘和争取潜在客户，增强公司的市场竞争优势和可持续发展能力与盈利能力，使公司在行业集中度较高的环境中占据更有利的地位。公司

拟以全资子公司江苏汇成作为项目实施主体，投资建设“12 吋晶圆金凸块封测项目”。预计项目投资总额人民币 32,294.90 万元，建设期计划 18 个月（不含前期工作）。

根据项目建设的资金需求和预计实施进度，公司拟使用自有资金人民币 30,000.00 万元向江苏汇成进行增资，本次增资完成后，江苏汇成注册资本由人民币 26,164.02 万元增至人民币 56,164.02 万元，公司仍持有江苏汇成 100% 股权。

公司于 2022 年 12 月 20 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资并投资建设 12 吋晶圆金凸块封测项目的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权公司和江苏汇成管理层全权办理本次增资并投资建设项目的有关手续和签署相关法律文件。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、本次投资项目基本情况

（一）项目名称：12 吋晶圆金凸块封测项目

（二）建设地点：扬州高新技术产业开发区

（三）项目主要内容：项目规划利用现有闲置的生产厂房，建设晶圆封测生产线，购置相关生产检测设备，实现年产晶圆测试（CP）12 万片、玻璃覆晶封装（COG）18,000 万颗和薄膜覆晶封装（COF）2,900 万颗的生产规模。

（四）项目投资总额：预计总投资人民币 32,294.90 万元，其中：建设投资人民币 31,937.10 万元，铺底流动资金人民币 357.80 万元，投资金额明细以最终审批及实际投资为准。

（五）项目资金来源：公司对江苏汇成增资的资金以及江苏汇成其他自筹资金和自有资金。

（六）项目建设周期：项目建设工期计划 18 个月（不含前期工作），公司董事会授权公司和江苏汇成管理层根据市场的发展情况、设备的交期、客户的论

证及对未来市场的判断等适时推进。

### 三、本次增资标的基本情况

#### （一）基本情况

公司名称：江苏汇成光电有限公司

法定代表人：郑瑞俊

注册资本：人民币 26,164.02 万元

成立日期：2011 年 8 月 29 日

注册地址：江苏扬州高新技术产业开发区金荣路 19 号

经营范围：半导体（硅片及化合物半导体）集成电路产品及半导体专用材料的开发、生产、封装和测试，销售本公司自产产品及售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：本次增资前后，公司持有江苏汇成 100% 股权

增资方式：公司自有资金

#### （二）财务情况

江苏汇成最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日/ 2022 年 1-9 月（未经审计）	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度（经审计）
总资产	547,163,280.46	515,099,798.09
净资产	50,720,953.97	40,507,697.36
总负债	496,442,326.49	474,592,100.73
营业收入	169,746,821.51	295,603,394.27
净利润	7,975,206.45	19,920,638.65
扣除非经常性损益 后的净利润	-6,461,643.93	14,038,995.45

注：江苏汇成的 2021 年度数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表标准无保留意见；2022 年 1-9 月的财务数据未经审计。

### 四、本次对外投资事项对公司的影响

本次向全资子公司增资并投资建设 12 吋晶圆金凸块封测项目是公司为实现

战略发展目标，立足长远利益所作出的慎重决策，优化产业布局和适度扩大 12 吋晶圆金凸块封测产能规模，以承接更多的订单及挖掘和争取潜在客户，从而进一步拓宽市场份额，有利于上下游产业链和供应链的紧密合作，增强公司的市场竞争优势和可持续发展能力与盈利能力，使公司在行业集中度较高的环境中占据更有利的地位。

本次对外投资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

## 五、项目建设的风险分析

### （一）市场管理风险

子公司江苏汇成的客户集中度较高，若无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新的客户资源，或者未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，将对项目的预期成果及收益产生一定的不确定性。

### （二）项目管理和人员风险

本项目建设内容较多，未来若由于项目管理单位缺乏管理经验等，可能导致投产不及时；若项目建成运营后由于缺少专业管理人员等造成管理效率低下，可能给项目带来经营风险。

### （三）项目资金风险和财务管理风险

本项目投资金额较大，若项目建设资金未能及时落实和到位，可能导致项目无法按期实施；若项目建设中和建成后，资金计划预算管理不严格，资金调配不合理，将影响资金的流动性和安全性。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日